

## 苏州国芯科技股份有限公司

# 关于自愿披露公司研发的新一代汽车电子 DSP 芯片产品内部测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)研发的新一代汽车电子DSP(Digital Singnal Processor, 数字信号处理器)芯片产品“CCD5001”于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下:

### 一、新产品的基本情况

公司本次成功研发的CCD5001芯片产品是基于HIFI5架构内核研发的高性能DSP芯片,适用于车载平台的有源噪声控制、高阶环绕音效、智能语音交互等需要极低时延、高浮点性能以及多通道信号处理的应用场景,也能够覆盖工业、交通等领域中需要高可靠性的信号处理或实时控制的应用场景。

该芯片对标ADI的ADSP-21565芯片,基于12nm工艺开发和生产,DSP工作主频800MHz,芯片内置768KB L1 SRAM和1MB L2 SRAM,支持多种数字音频接口(SPORT、SPDIF)和滤波器硬件加速器(FIR、IIR),支持SPI、QSPI、OSPI、I2C、UART、PWMT、PIT、GPIO(EPORT)等多种外设接口,并支持应用程序的安全保护机制;CCD5001芯片按照汽车电子Grade2等级进行设计和生产,具备高可靠性和高安全性,可以应用于汽车及工业等环境条件苛刻的使用场景,从而增加了产品的应用覆盖面,封装形式为LQFP120,可以对ADI公司的ADSP-21565形成替代,可以广泛应用于车载智能音效方案涉及的各类应用,有望为解决我国汽车产业中DSP芯片“缺芯”问题作出贡献。

目前,该汽车电子DSP芯片新产品已给客户送样并开展模组开发和测试。

### 二、对公司的影响

公司对上述芯片产品具有完全自主知识产权，在开发阶段该产品就受到国内主动降噪、车载音效、智能语音交互等模组和算法方案厂商的关注和支持，已有客户利用该芯片开展了模组及系统软件的前期开发。该款新产品的研发成功进一步增强了公司在汽车专用 SoC 芯片领域的市场壁垒，丰富了公司汽车电子芯片产品系列，对公司未来汽车电子业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。

### 三、风险提示

本次测试目前为公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试，相关工作已经在开展进行中。本次公司推出的汽车电子 DSP 芯片新产品 CCD5001 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日